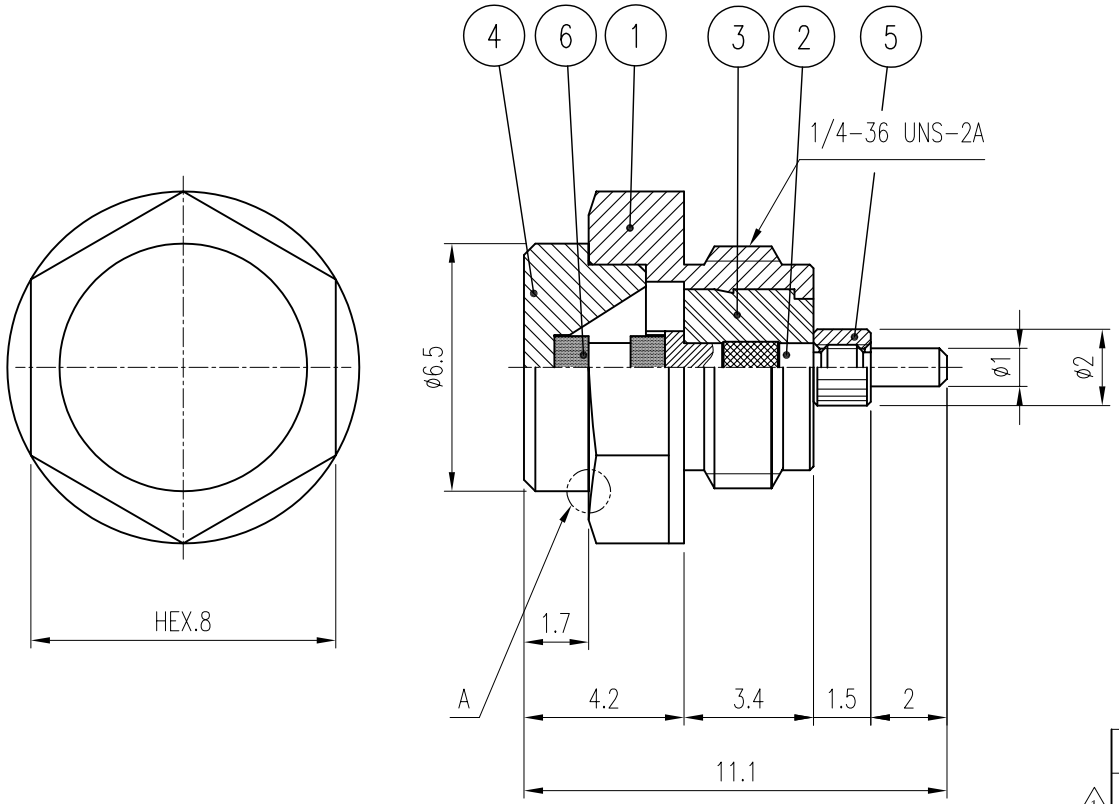
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	신뢰성 향상[설변No.연구2007-003] (SPEC변경으로 인한 PIN 변경 및 저항 값 변경)	김은희	윤상진	2007. 1. 8.
2	신뢰성향상[설변NO. 연구2007-134] (녹시 배늘 주기 및 형상변경)	최유나	윤상진	2007. 08. 02.

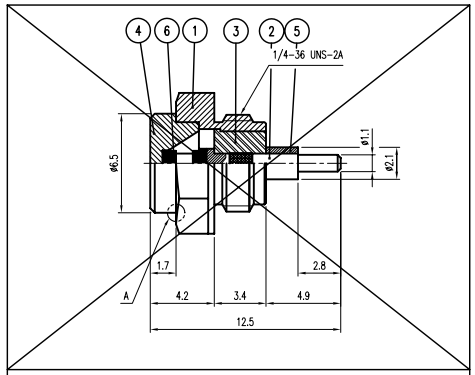


조 립 주 기

1. 절연체에 PIN을 밀어 넣어 조립한다.
2. 조립된 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것.>
5. 4번까지 조립된 상태에 NUT를 나사 체결 후 PIN 2mm를 확인한다.
   (LOC TITE를 바른다.)
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.

1 ~~<저항값 48~50Ω>~~ <저항값 48~52Ω>

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
1	5	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00135-5/1 (M2021)
	4	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00068-5/1 (L2044)
2	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01123-N/1 (H2359)
1	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01840-5/1 (E2537)
2	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01687-5/1 (D2521)



설변 전 VER.0

대체가능재질			
공통공차	년월일	2006. 12. 5.	
소수 각도 분수	승인		
재질	검도		
열처리	제도		
보호피막처리	직성부서	연 구 소	
	척도 NS	단위 mm	중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-내장형TERM VER.2

A4

도번 TM00024-7/1

K314-953-003